

# 真空加圧含浸による絶縁回復

分解点検・整備

真空加圧含浸



## ■ドブ付け処理

絶縁物の表面、表面クラックをワニスで覆う



導体

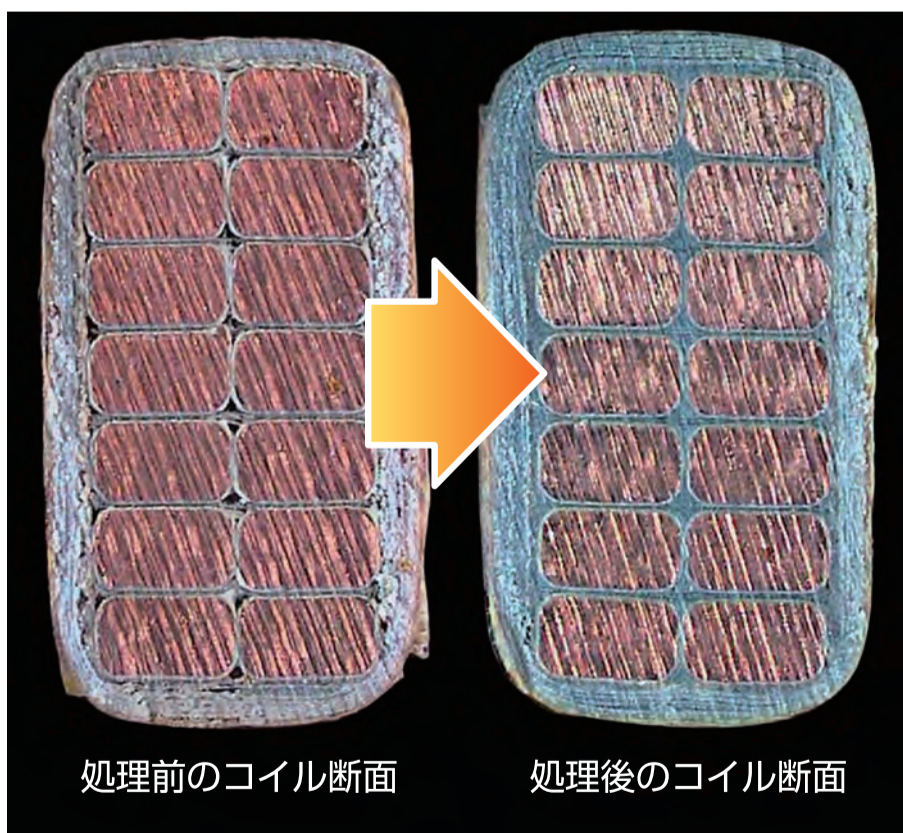
## ■真空加圧含浸処理

絶縁物内部のボイドに至るまでワニス充填



導体

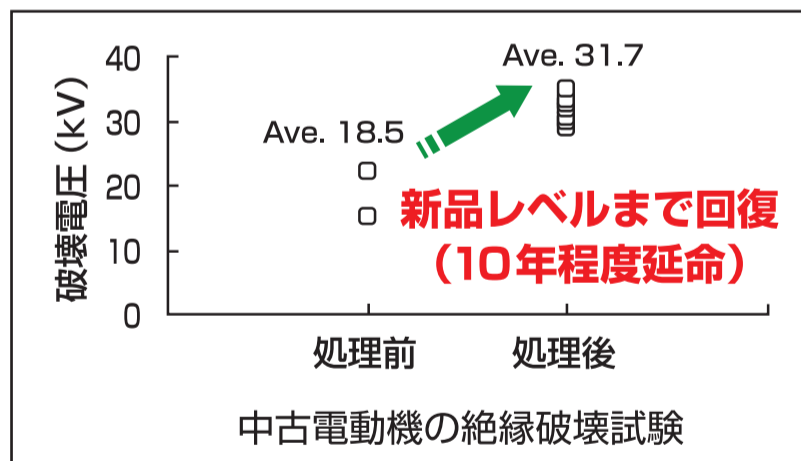
ボイドレス改善



処理前のコイル断面

処理後のコイル断面

絶縁破壊電圧改善



絶縁診断項目		処理前	処理後
直流漏れ電流試験	PI 値	4.45	5.56
交流電流試験	PI1	2.80kV	3.30kV 超え
誘電体損失角試験	tan δ0	1.78%	1.43%
	Δtan δ	3.62%	0.41%
	静電容量	32.0nF	42.0nF
部分放電試験	CSV	2.33kV	2.53kV
	Qmax	11600pC	9400pC

処理後は、ボイドが修復され、絶縁破壊電圧が上昇、 $\Delta \tan \delta$  が改善されることが確認されています。

\* 使用環境・状況により変動することがあります。

注) 真空加圧含浸に適さない条件がありますので、ご相談ください。



JFE プラントエンジニアリング 株式会社